

2023年12月

电子元器件销售 行情分析与预判



正文目录

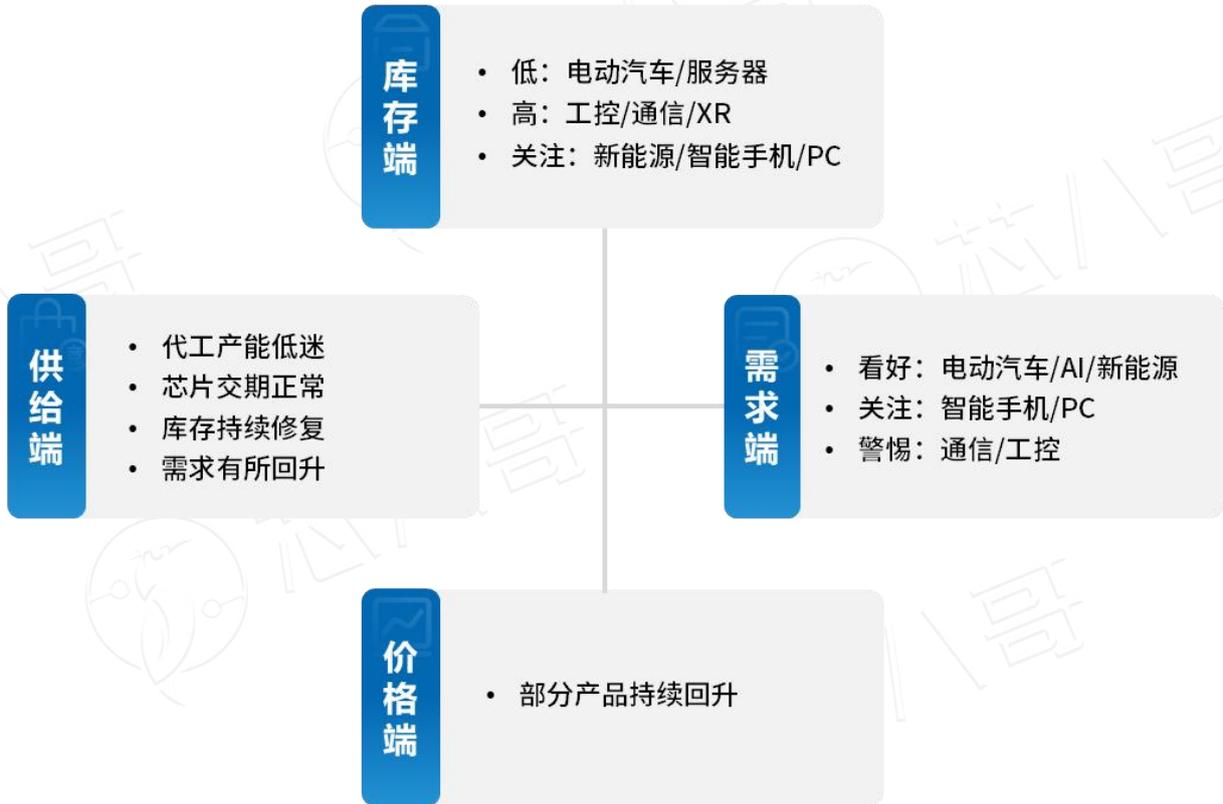
序章	2
一、12月宏观经济	2
1、全球制造业弱势波动，下行风险仍存	2
2、电子信息制造业有所回升，降幅收窄	3
3、半导体销售和产量持续增长，反弹强劲	4
二、12月芯片交期趋势	6
1、整体芯片交期趋势	6
2、重点芯片供应商交期一览	7
三、12月订单及库存情况	19
四、12月半导体供应链	21
1、半导体上游厂商	21
(1) 硅晶圆/设备	21
(2) 原厂	22
(3) 晶圆代工	24
(4) 封装测试	25
2、分销商	26
3、系统集成	26
4、终端应用	28
(1) 消费电子	28
(2) 新能源汽车	29
(3) 工控	30
(4) 光伏	31
(5) 储能	32
(6) 服务器	32
(7) 通信	33
五、分销与采购机遇及风险	34
1、机遇	34
2、风险	34
六、小结	35
免责声明	36

图表目录

图表 1: 12 月全球主要经济体制造业 PMI	3
图表 2: 2023 年最新电子信息制造业运行情况	3
图表 3: 2023 年最新全球半导体行业销售额及增速	4
图表 4: 2023 年最新全球及中国集成电路产量及增速	5
图表 5: 2023 年最新中国集成电路进出口金额及增速	5
图表 6: 12 月费城及申万半导体指数走势	6
图表 7: 12 月芯片交期趋势	6
图表 8: 2023 年 12 月主要厂商交期及趋势一览	7
图表 9: 12 月头部企业订单及库存情况	19
图表 10: 12 月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况	21
图表 11: 12 月主要原厂最新动态	22
图表 12: 12 月主要晶圆代工厂最新动态	24
图表 13: 12 月主要封测厂商动态情况	25
图表 14: 12 月主要元器件分销商最新动态	26
图表 15: 12 月主要系统集成商最新动态	26
图表 16: 12 月消费电子厂商最新动态	28
图表 17: 12 月新能源汽车厂商最新动态	29
图表 18: 12 月工控厂商最新动态	30
图表 19: 12 月光伏厂商最新动态	31
图表 20: 12 月储能厂商最新动态	32
图表 21: 12 月服务器厂商最新动态	32
图表 22: 12 月通信厂商最新动态	33
图表 23: 12 月细分市场机会关注	34
图表 24: 12 月细分市场风险预警	34

序章

岁序更新 周期向上



一、12月宏观经济

1、全球制造业弱势波动，下行风险仍存

12月，全球经济继续弱势下行，包括中国、美国及欧盟等主要经济体弱势波动特征没有改变。回顾2023年，下半年以来经济呈现稳定恢复、结构向好发展态势。展望2024年经济有望继续回升向好。

图表 1: 12月全球主要经济体制造业 PMI



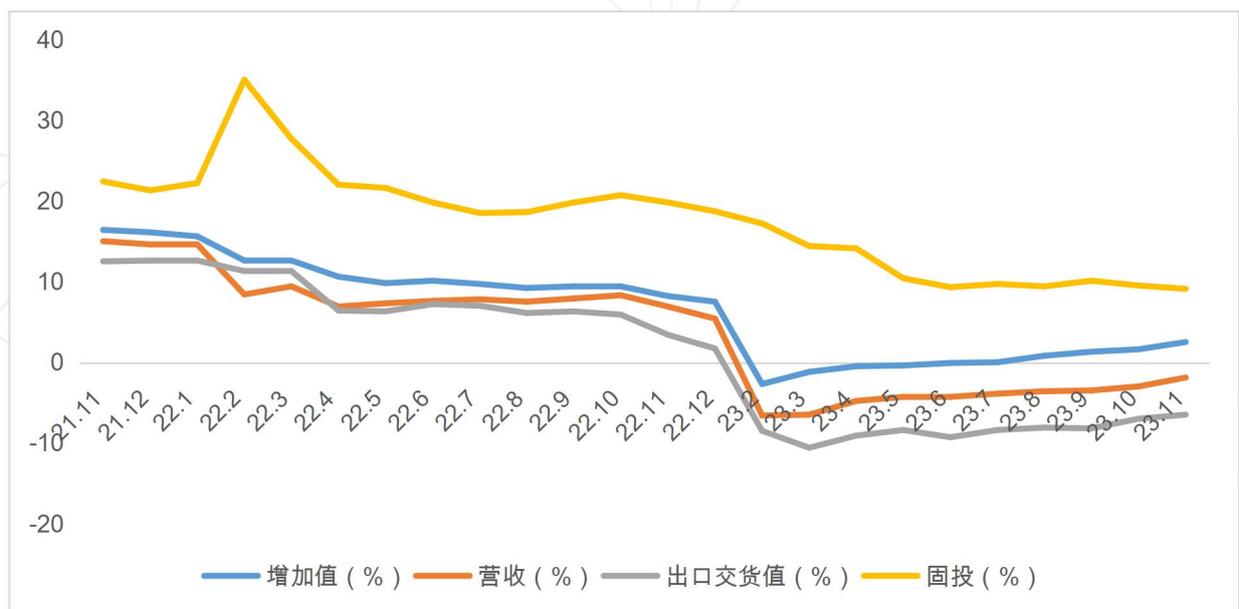
资料来源：国家统计局

经合组织（OECD）预测，2024 年经济增速为 2.7%，较 2023 年预期低 0.2 个百分点。

2、电子信息制造业有所回升，降幅收窄

2023 年 1-11 月，中国电子信息制造业生产加快回升，出口降幅持续收窄，效益加快恢复，投资略有下滑，多区域营收有所提升。

图表 2: 2023 年最新电子信息制造业运行情况

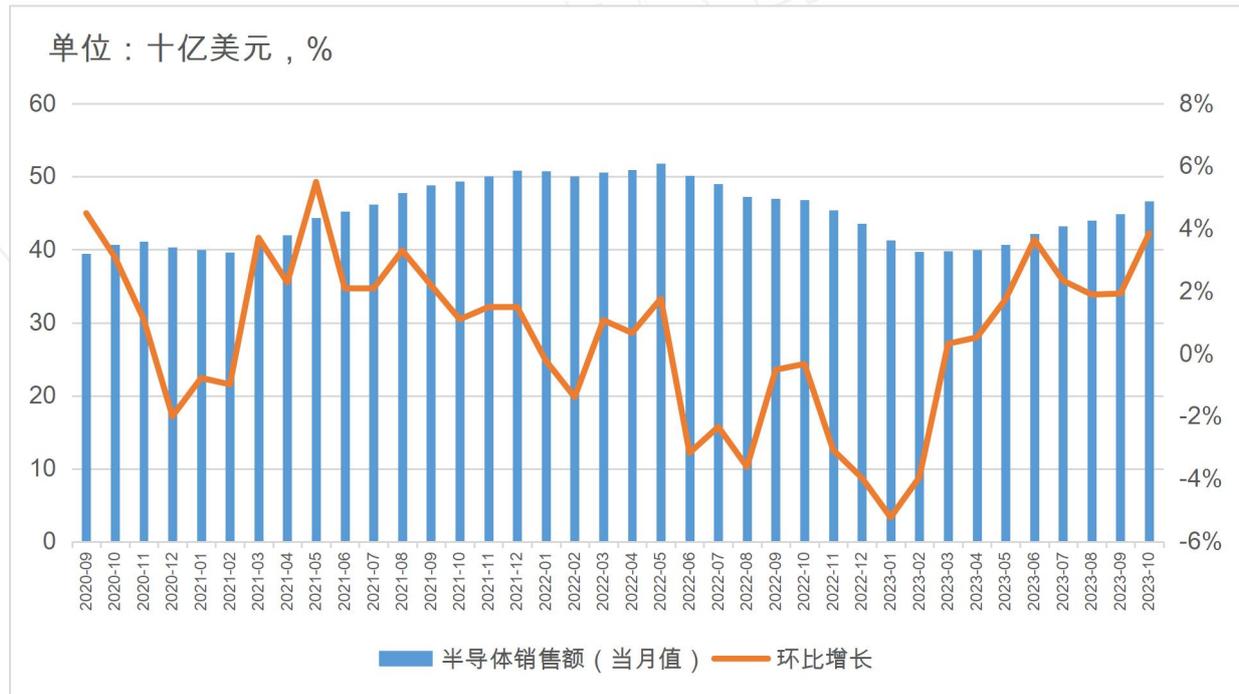


资料来源：工信部

3、半导体销售和产量持续增长，反弹强劲

根据 SIA 最新数据，10 月全球半导体销售额达 466.2 亿元，环比增长 3.9%，连续第八个月环比增长。

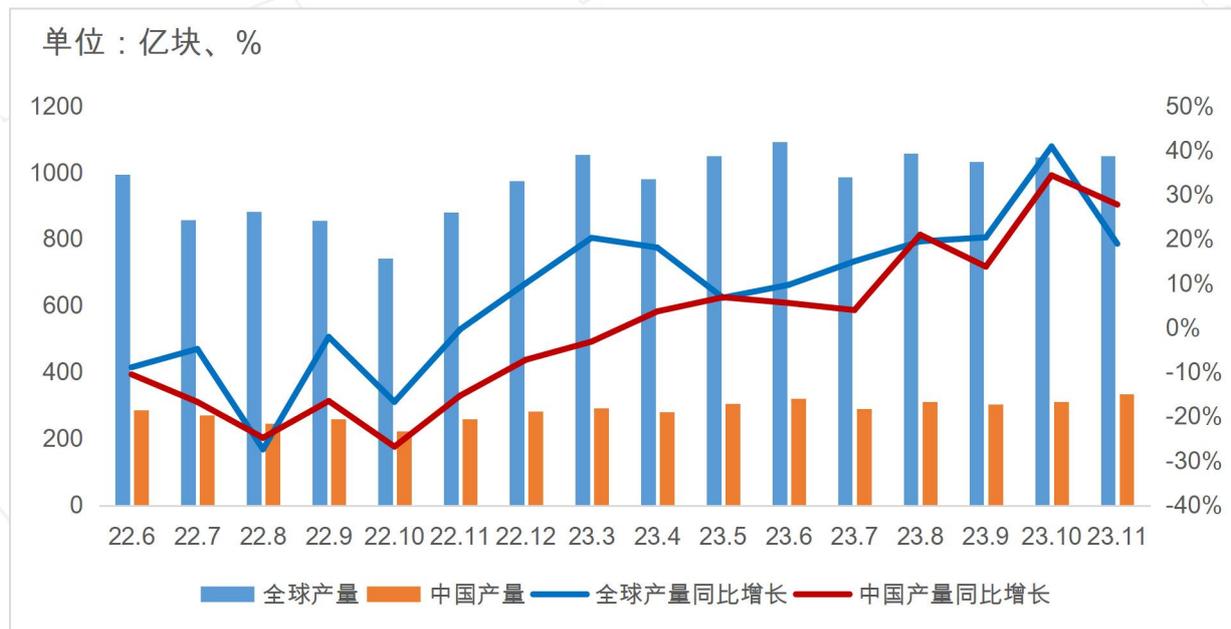
图表 3：2023 年最新全球半导体行业销售额及增速



资料来源：SIA、芯八哥整理

从集成电路产量看，11 月全球集成电路产量约 1048 亿块，同比增长 19.1%；中国产量达 313 亿块，同比增长 27.9%，产量持续回升趋势明显。

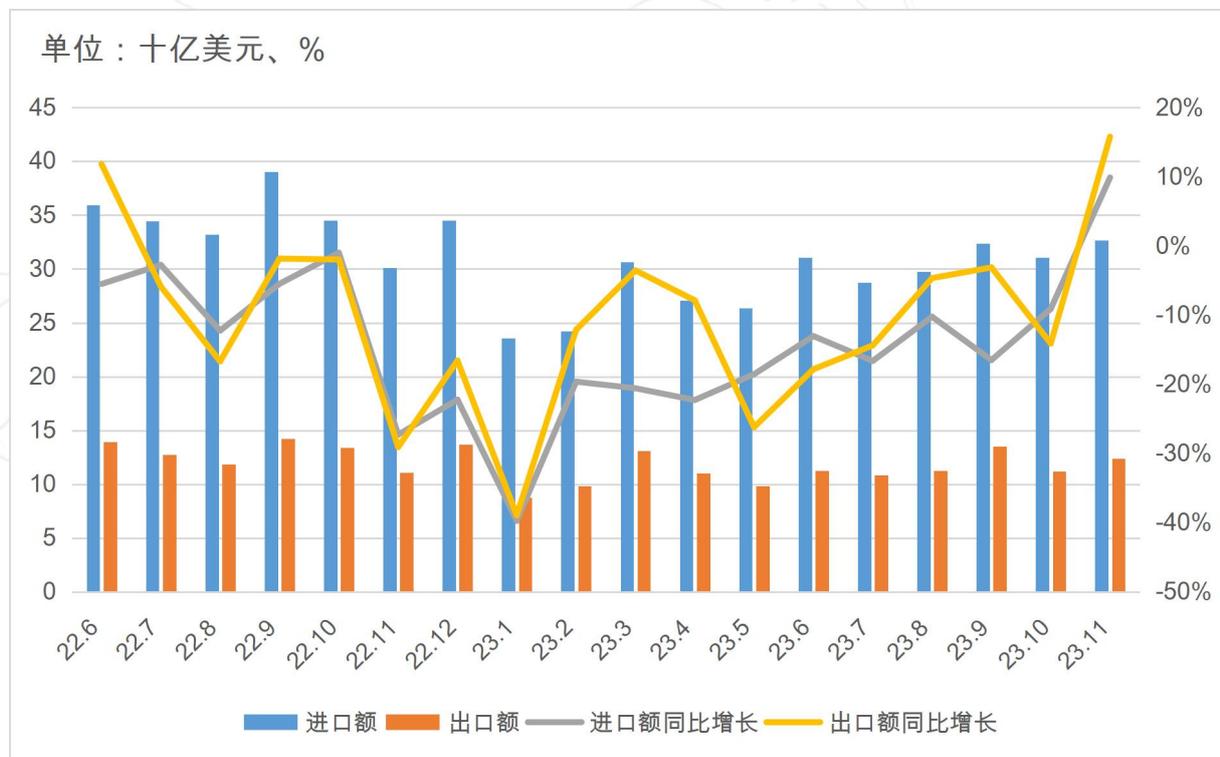
图表 4：2023 年最新全球及中国集成电路产量及增速



资料来源：工信部、SIA、芯八哥整理

进出口方面，11 月中国集成电路进出口金额年内首次转正，外部需求呈现回暖迹象。

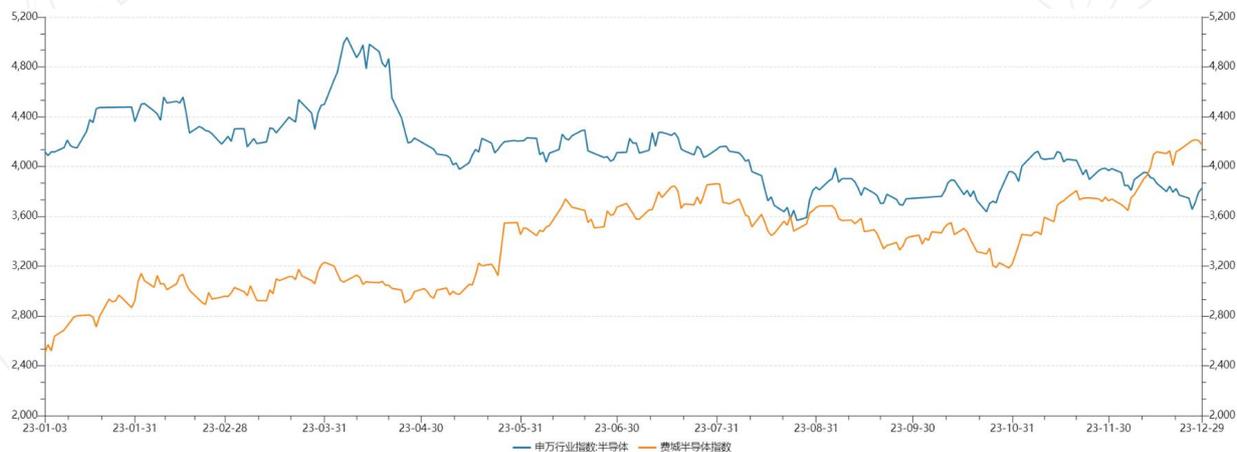
图表 5：2023 年最新中国集成电路进出口金额及增速



资料来源：工信部、SIA、芯八哥整理

从资本市场指数来看，12月费城半导体指数(SOX)上涨11.70%，中国半导体(SW)行业指数下降3.98%，市场交易持续复苏。

图表 6: 12月费城及申万半导体指数走势



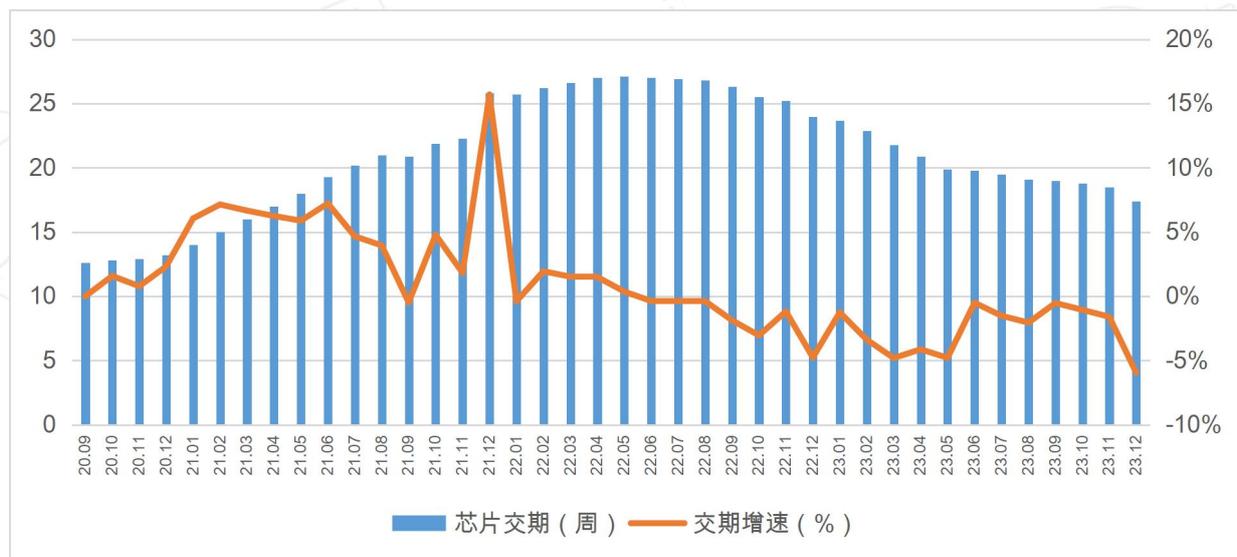
资料来源: Wind

二、12月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

12月，全球芯片交期逐步回归常态，需求复苏下行业重回上升周期。

图表 7: 12月芯片交期趋势



资料来源: SFG、芯八哥整理

2、重点芯片供应商交期一览

从 12 月各供应商看，交期缩短趋势尤为明显。其中，模拟芯片降幅较大，价格倒挂严重；DRAM 和 NAND 等存储芯片价格持续回升；MOSFET/IGBT 等功率器件改善明显；MCU 价格趋于稳定。

图表 8：2023 年 12 月主要厂商交期及趋势一览

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	AMS OSRAM	传感器	16-24	8-24	稳定	根据市场调整
	BOSCH	传感器	12-20	6-12	稳定	稳定
	Diodes	多源模拟/ 电源	30-40	20-32	稳定	稳定
		开关稳压 器	25-45	20-45	稳定	稳定
	FTDI Chip	接口	26-40	14-24	缩短	稳定
	Infineon	传感器	18-52	18-52	稳定	上升
		开关稳压 器	40-52	20-52	稳定	稳定
		汽车模拟	45-52	45-52	稳定	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		和电源				
	ADI (Maxim)	放大器和 数据转换 器	20-30	15-30	缩短	上升
		接口	20-30	18-30	缩短	上升
		开关稳压 器	20-35	20-30	缩短	稳定
	Microchip	放大器和 数据转换 器	30-40	4-10	缩短	稳定
		定时	30-40	7-12	缩短	稳定
		开关稳压 器	40-50	4-25	缩短	上升
	MPS	开关稳压 器	45-50	20-42	缩短	稳定
	NXP	传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
		接口	26-30	20-30	缩短	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		汽车模拟 和电源	45-52	24-35	缩短	稳定
	On Semi	传感器	18-52	18-52	稳定	根据市场调 整
		放大器和 数据转换 器	26-42	18-26	缩短	稳定
		定时	35-42	20-42	稳定	稳定
		多源模拟/ 电源	35-42	20-40	稳定	稳定
		开关稳压 器	35-50	20-40	稳定	上升
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	稳定
	Renesas	放大器和 数据转换 器	36-40	24-36	缩短	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		定时	50	50	稳定	稳定
		接口	36-40	24-36	缩短	稳定
		开关稳压 器	36-40	36-40	缩短	上升
	ROHM	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		开关稳压 器	50	20-40	稳定	稳定
	ST	传感器	12-18	12-18	缩短	稳定
		放大器 和数据转换 器	20-36	14-24	缩短	稳定
		多源模拟/ 电源	40-50	20-42	缩短	稳定
		开关稳压 器	40-50	20-40	缩短	稳定
		汽车模拟	40-52	40-52	稳定	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		和电源				
	TE	传感器	16-52	16-52	稳定	根据市场调整
	Vishay	传感器	24-52	24-52	延长	稳定
射频 和无 线	Infineon	蓝牙模块	26-36	26-36	稳定	稳定
	Microchip	WiFi 模块	24-26	16-26	稳定	稳定
		蓝牙模块	24-26	12-26	稳定	稳定
		收发器/接收器	18-20	18-20	稳定	上升
	Murata	WiFi 模块	26-50	26-50	稳定	稳定
		蓝牙模块	26-50	26-50	稳定	稳定
	Laird	WiFi 模块	26-52	20-40	稳定	稳定
		天线	16-20	12-16	延长	稳定
	ST	蓝牙模块	12-16	10-12	稳定	稳定
		收发器/接收器	52	12	稳定	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		RFID	30-40	20	稳定	稳定
	NXP	收发器/接收器	24	24	稳定	上升
		RFID	20-40	13	稳定	稳定
		大功率 IC	52	12-16	稳定	稳定
		On Semi	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定
分立器件	Diodes	低压 MOSFET	18-52	8-16	缩短	根据市场调整
		TVS 二极管	18-24	8-14	缩短	稳定
		桥式整流器	12-40	8-30	稳定	稳定
		肖特基二极管	14-35	14-20	缩短	稳定
		整流器	14-40	8-30	稳定	稳定
		开关二极管	12-52	12-20	稳定	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		管				
		小信号 MOSFET	30-45	12-30	缩短	稳定
		齐纳二极 管	14-35	12-20	缩短	稳定
		双极晶体 管	14-45	12-20	缩短	稳定
		数字晶体 管/RETS	14-35	12-20	缩短	稳定
		通用晶体 管	14-35	12-20	缩短	稳定
		逻辑器件	20-22	8-10	稳定	稳定
	Infineon	低压 MOSFET	18-48	10-36	缩短	根据市场调 整
		高压 MOSFET	39-56	12-40	缩短	稳定
		IGBT	39-50	14-52	稳定	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		宽带隙 MOSFET	42-52	26-52	稳定	稳定
		数字晶体 管/RETS	12-52	6-50	稳定	稳定
		通用晶体 管	12-52	6-50	稳定	稳定
		军用-航空 晶体管	22-45	22-52	稳定	稳定
	ST	低压 MOSFET	50-54	50-54	缩短	稳定
		高压 MOSFET	47-52	14-40	缩短	稳定
		IGBT	47-52	14-52	缩短	稳定
		ESD	30-45	21-32	缩短	稳定
		宽带隙 MOSFET	42-52	42-52	稳定	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		晶闸管 /Triac	15-16	15-16	稳定	稳定
		TVS 二极 管	30-40	25-30	稳定	根据市场调 整
	Wingtech (Nexperia)	整流器	44-46	14-16	稳定	稳定
		双极晶体 管	40-52	40-52	稳定	稳定
		低压 MOSFET	40-52	4-20	缩短	根据市场调 整
		ESD	12-40	6-18	稳定	稳定
		肖特基二 极管	4-20	4-16	缩短	稳定
		开关二极 管	8-50	4-16	缩短	稳定
		小信号 MOSFET	10-26	8-16	缩短	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		齐纳二极 管	4-20	4-16	缩短	稳定
		双极晶体 管	4-20	4-16	缩短	稳定
		数字晶体 管/RETS	4-20	4-16	缩短	稳定
		通用晶体 管	4-20	4-16	缩短	稳定
		逻辑器件	6-8	6-8	稳定	稳定
MCU	Renesas	8 位 MCU	18-24	12-18	缩短	稳定
		32位 MCU	18-24	18	缩短	稳定
		汽车	45	45	稳定	稳定
		32位 MPU	18-26	18-26	稳定	稳定
	ST	8 位 MCU	35-52	35-52	缩短	稳定
		汽车	40-52	40-52	稳定	稳定
32位 MPU		16-20	16-20	缩短	稳定	

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		STM32FO	16-20	10-12	缩短	稳定
		STM32F1	16-20	16-20	缩短	稳定
		STM32L	16-20	16-20	缩短	稳定
		32位 MCU	35-48	20-28	缩短	稳定
	Infineon	8位 MCU	26-52	10-14	缩短	稳定
		32位 MCU	26-52	10-52	缩短	稳定
		汽车	32-45	紧缺	稳定	稳定
	Microchip	8位 MCU	36-52+	4-16	缩短	稳定
		32位 MCU	36-52+	4-28	缩短	稳定
		32位 MPU	30-52	4-24	稳定	稳定
	NXP	8位 MCU	26-52	13-39	缩短	稳定
		32位 MCU	13-52	13-39	缩短	稳定
		汽车	35-52	18-52	稳定	稳定
		32位 MPU	18-52	18-52	缩短	稳定
可编	AMD (Xilinx)	FPGA	20-65	20-50	缩短	稳定
程逻	Intel (Altera)		30-55	30-55	稳定	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
辑器 件	Lattice		30-50	28-42	缩短	稳定
	Microchip (Microsemi)		32-42	10-44	缩短	稳定
存储 器	Samsung	DRAM (商 用 PC)	52-54	52-54	稳定	稳定
		存储器模 块	52-54	52-54	稳定	稳定
		eMMC	52-54	52-54	稳定	稳定
		固态驱动 器(SSD)	52-54	52-54	稳定	稳定
	SK Hynix	NAND flash	6-10	6-10	缩短	根据市场调 整
		eMMC	8-12	8-12	稳定	稳定
被动 元件	Murata	滤波器	12-16	12-16	稳定	稳定
		电感/变压 器	12-20	12-20	稳定	稳定

类别	供应商	产品	23.12 交期/周	24.1 交期/周	交期趋势	价格趋势
		引线陶瓷 电容	16-18	16-18	稳定	稳定
		专用电容	15-16	15-16	稳定	稳定
	TDK	滤波器	40-55	12-16	延长	稳定
		电感/变 压器	16-20	16-20	稳定	稳定
		表面贴装 通用陶瓷 电容(车规 级)	30-42	30-42	稳定	稳定

资料来源：富昌电子、Wind、芯八哥整理

三、12月订单及库存情况

从企业订单看，工业/通信相关厂商需求低迷，消费类需求上升，汽车/AI 等需求维持快速增长。主要厂商库存去化接近尾声，需求逐渐回升。

图表 9：12月头部企业订单及库存情况

公司	12月订单情况	12月库存情况	1月定价趋势
Intel	稳定	一般	稳定

公司	12月订单情况	12月库存情况	1月定价趋势
AMD	稳定	一般	稳定
三星	稳定	一般	上升
TI	稳定	较高	根据市场调整
ST	稳定	低	根据市场调整
ADI	稳定	低	根据市场调整
Qualcomm	稳定	一般	下降
Broadcom	稳定	一般	根据市场调整
NXP	稳定	低	根据市场调整
Infineon	上升	低	根据市场调整
Renesas	稳定	低	根据市场调整
Onsemi	稳定	无	稳定
Microchip	稳定	一般	稳定
Micron	稳定	一般	上升
SK Hynix	稳定	一般	上升
Murata	稳定	低	稳定
联发科	稳定	一般	根据市场调整

注：高 > 较高 > 一般/稳定 > 较低 > 低 > 无

四、12 半导体供应链

设备/材料需求稳定，代工产能低迷，原厂订单回升，终端持续回暖。

1、半导体上游厂商

(1) 硅晶圆/设备

12 月，原料订单延续低迷，中国市场设备订单需求上升。

图表 10：12 月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况

类型	企业	12 月订单	12 月库存	1 月订单预测
设备	ASML	上升	低	上升
	AMAT	稳定	低	稳定
	泛林	稳定	低	稳定
	TEL	稳定	低	稳定
	科磊	稳定	低	稳定
	北方华创	上升	低	上升
	中微公司	上升	低	上升
硅晶圆	信越化学	下降	一般	下降
	Sumco(胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降

类型	企业	12月订单	12月库存	1月订单预测
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	上升	一般	上升

资料来源：芯八哥整理

(2) 原厂

12月，主要原厂在汽车/AI等领域需求维持较高景气度，关注存储价格回升趋势。

图表 11：12月主要原厂最新动态

厂商	12月动态
Intel	将在美国加州裁员 311 人；Gaudi AI 芯片订单已达 20 亿美元
AMD	2023 年 AI 芯片规模 450 亿美元，2024 年供应大增
英伟达	高需求使 GPU 提前预定时间延长至 52 周
TI	持续减产，库存有所改善
Qualcomm	看好 AI 发展潜力
三星	2024 年半导体投资同比增长 25%
联发科	与美光达成全球和解协议
Broadcom	拟扩大裁员近 3000 人
ADI	2024 年 2 月起涨价最高达 20%；拟开启新一轮裁员

厂商	12月动态
ST	与理想汽车签署 SiC 长期供货协议
Infineon	车企与半导体厂商签订长约成新趋势
NXP	预计 2024 年新能源车全球占比提高至 40%
Qorvo	将两家中国工厂出售给立讯精密
Onsemi	车规料交期和价格改善并不明显
TOSHIBA	短期内首要目标是扩大功率半导体产能
WD	NAND 未来几季涨价 55%，HDD 也将上涨
SK Hynix	Q3 服务器 DRAM 市场份额近 50%；2024 年增加半导体投资，同比增长 100%
Micron	2024 年 HBM 产能已全部售罄；存储价格持续上涨
Marvell	Q3 数据中心增长超预期
威刚	存储市场高景气度可能维持一年半到两年
兆易创新	NOR Flash 和 SLC Nand Flash 价格趋稳
盛群	MCU 市场尚未明显复苏
华为海思	Q3 手机芯片份额进入 Top5
新唐科技	MCU 市场尚未明显复苏
长鑫存储	推出 LPDDR5 系列产品

厂商	12月动态
慧荣	NAND 在 2024 年将逐季甚至逐月涨价
中颖电子	家电类 MCU 订单仍在继续
华邦	Q4 存储产能利用率将逐步回升
旺宏	存储需求 2024 年下半年复苏
福建晋华	与美光达成全球和解协议

资料来源：芯八哥整理

(3) 晶圆代工

12月，先进制程订单快速增长，成熟制程产能持续低迷。

图表 12：12月主要晶圆代工厂最新动态

厂商	12月产能利用率	12月动态	1月价格趋势
台积电	85%	11月、12月营收平均值将月减逾20%；3nm 客户再现排队潮	稳定
三星	80%	美国泰勒市晶圆厂将延后至2025年量产	下降
联电	61%	Q4利用率预计为61%~63%	下降
中芯国际	77%	2023Q3晶圆代工份额约6%	下降
格芯	85%	2023Q3晶圆代工份额约6%	稳定

厂商	12月产能利用率	12月动态	1月价格趋势
世界先进	55%	终端市场需求仍相对疲弱	下降
力积电	60%	或以价换量	下降
华虹	90%	积极扩产 CIS/ISP 与功率半导体产能	下降

资料来源：芯八哥整理

(4) 封装测试

12月，先进封装需求供不应求，行业复苏趋势明显。

图表 13：12月主要封测厂商动态情况

厂商	12月产能利用率	12月动态	1月订单预测
日月光	65%	看好 AI、HPC 及车用等需求回升，先进封装 订单供不应求	上升
长电科技	80%	当前市场需求仍存在不确定性	稳定
通富微电	85%	AMD 订单需求增加	稳定
华天科技	85%	2023Q2 以来市场逐步缓慢恢复	下降
气派科技	70%	订单有改善趋势	下降
中小封测厂	60%	行业订单持续回升	下降

资料来源：芯八哥整理

2、分销商

12月，整体分销市场需求逐步回升，2024年行业复苏可期。

图表 14：12月主要元器件分销商最新动态

厂商	12月动态
大联大	2024年市况有望优于2019年；Q4手机需求有反弹迹象
文晔科技	Q4需求有回升
中电港	公司授权产品线130多条
香农芯创	库存改善明显
商络电子	新能源汽车客户正在年底冲量，订单需求较好；通讯和工业需求平缓
雅创电子	汽车领域业务进展良好
好上好	库存有小幅波动

资料来源：芯八哥整理

3、系统集成

12月，工控需求未见改善，新能源汽车需求稳定，消费类需求持续上升。

图表 15：12月主要系统集成商最新动态

类别	厂商	12月动态
工控	ABB	依托上海浦东基地加速中国市场布局
	霍尼韦尔	49.5亿美元收购开利全球安全业务

类别	厂商	12月动态
	施耐德电气	全系产品线在中国均有独立研发中心
	罗克韦尔	与微软就 AI 领域展开合作
	汇川技术	看好 2024 年传统 OEM 行业的恢复
汽车	电装	持续投资电动汽车相关领域
	大陆	计划剥离部分传统汽车业务
	博世	与苏州工业园区签署扩大产业合作协议；主流产品中国本土化率在 80%-90%
	舍弗勒	拟将纬湃收购价提升至 38 亿欧元
	安波福	进一步深化本土战略，中国区成独立事业部
	采埃孚	电机产量突破 300 万台
	博格华纳	电动汽车相关产品组合亏损比预期更长
消费电子	闻泰科技	笔电产品 2024 年将有快速增长
	华勤技术	笔电及服务器业务增长显著
	立讯精密	汽车业务拓展顺利
	歌尔股份	消费类相关需求缓慢回暖
	鸿海	增资 5530 万美元，持续扩大印度产能

资料来源：芯八哥整理

4、终端应用

(1) 消费电子

12月，消费电子行业需求复苏加速，AI引领产业升级。

图表 16：12月消费电子厂商最新动态

类别	企业	12月动态
智能手机	苹果	印度市场产能不断提升
	三星	计划 2024 年生产逾 2.4 亿部智能手机
	华为	2024 年手机出货同比增幅或达 37%
	OPPO	2024 年或提高 6%~9%产量
	传音	预计 2023 年净利润 54.93 亿元，增长 121.15%
	荣耀	已要求供应商在 2024 年提供更多支持
PC	联想	发布全球首款商务 AI PC
	宏碁	印度市场已经是继美国第二大市场
	戴尔	乐观看待 2024 年 PC 业绩增长
	广达	笔电需求回暖
VR/AR	Meta	2024 年将发布多款 VR 产品
	苹果	预估 2024 年 Vision Pro 出货约 50 万台

类别	企业	12月动态
	PICO	取消发布 PICO 5
	HTC	看好 2024 年 VR 业务表现
	爱奇艺	旗下 VR 公司停摆，新裁员启动

资料来源：芯八哥整理

(2) 新能源汽车

12月，新能源汽车维持稳定增长，但市场竞争加剧。

图表 17：12月新能源汽车厂商最新动态

厂商	12月动态
比亚迪	或在匈牙利投资数十亿欧元设厂；Q4 纯电车型销量将超特斯拉
特斯拉	上海 Megapack 电池项目启动；拟重启上海三期工厂建设
本田	广汽本田宣布裁员 900 人
大众	50 亿元投资到账，大众与小鹏合作完成交割
宝马	2024 年目标交付超 50 万辆电动车
奔驰	电动汽车市场价格竞争激烈
丰田	暂停天津工厂部分生产
福特	推迟 120 亿美元的电动汽车投资计划
通用	拟裁员 1300 人

厂商	12月动态
广汽埃安	第100万辆整车下线
吉利	加速海外电车市场布局
奇瑞	将在新能源领域密集导入新品
蔚来	31.6亿元收购与江淮2座合作工厂；裁员比例扩大至20%~30%
理想	12月新车销量目标5万辆
长城	加快海外市场布局
小米	小米汽车投入3400名工程师，研发超100亿
华为	与奔驰等接洽汽车零部件公司股权出售

资料来源：芯八哥整理

(3) 工控

12月，工控行业需求仍偏弱，但国产化进一步提升。

图表 18：12月工控厂商最新动态

厂商	12月动态
西门子	中国重庆西部制造基地开工，重点生产汽车电子相关产品
安川电机	持续深耕中国市场
汇川技术	2023年行业整体需求较弱，国产化快速提升；看好汽车领域工业机器人应用
英威腾	工控为主的苏州产业园二期已投入使用

厂商	12月动态
禾川科技	获得博世 2.76 亿战略投资，拟在上海设立合资公司
埃斯顿	2024 年重点发展汽车、电子等下游行业
新时达	2023H1 公司机器人累计出货量已突破 4 万台

资料来源：芯八哥整理

(4) 光伏

12 月，光伏行业正加速去库存中，库存去化改善或延至 2024 年初。

图表 19：12 月光伏厂商最新动态

厂商	12月动态
阳光电源	公司库存保持合理水平，行业 2024 年会有转机
天合光能	2023 年底硅片、电池片、组件产能分别达 50GW、75GW、95GW
锦浪科技	库存去化改善要看 2024 年年初
固德威	2023Q4 公司需求缓慢回升，去库存预计可能到 2024Q1
英威腾	重点布局欧洲、美洲、印度、澳洲等海外市场
德业股份	亚非拉市场爆发持续性较强
昱能科技	Q4 销量相较往年有降幅

资料来源：芯八哥整理

(5) 储能

12月，以欧洲为主的海外经销商库存较高，去库存或需一定时间。

图表 20：12月储能厂商最新动态

厂商	12月动态
阳光电源	欧洲去库存是客观存在的
科士达	储能产品以户储和工商业储能为主
上能电气	库存压力不大；出口方面印度市场较多
科陆电子	公司储能基地在宜春，PCS在成都，计划扩展珠三角地区
德业股份	预计2024年大储需求持续提升
天合光能	公司储能电池、直流电池舱及交直流产品组合产能达12GWh
固德威	经销商库存压力较大
特斯拉	上海储能超级工厂项目正式启动
科华数据	家用户储出现囤货

资料来源：芯八哥整理

(6) 服务器

12月，高端AI服务器订单持续增长，2024年行业维持高景气度。

图表 21：12月服务器厂商最新动态

企业	12月动态
----	-------

企业	12月动态
英伟达	预计 2024 年 AI 服务器出货将增长 150%
AMD	发布 MI300 系列芯片
戴尔	高端 AI 服务器订单激增
新华三	开启裁员，中高层最高降薪 20%
纬创	2024 年 AI 服务器业务订单优于预期
广达	2024Q1 将提高 AI 服务器产量
工业富联	基于 H100/H800 等高性能 AI 服务器实现规模量产

资料来源：芯八哥整理

(7) 通信

12 月，行业头部厂商库存有所上升，部分投资有所缩减，行业竞争加剧。

图表 22：12 月通信厂商最新动态

企业	12月动态
思科	最新财季库存有所上升
华为	首家海外工厂落地法国，拟 2025 年底投产
中兴通讯	5G-A 技术实现规模商用
爱立信	与小米签署 5G 全球许可协议

企业	12月动态
诺基亚	丢失美国运营商 AT&T 140 亿美元 5G 合同
烽火通信	部分通信相关投资项目延期

资料来源：芯八哥整理

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

12月，看好AI相关核心芯片品类需求增长，消费电子复苏下驱动IC需求有望回升。

图表 23：12月细分市场机会关注

产品	市场机会	相关企业
显示驱动 IC	2024 年全球显示投资将增加 82%至 85 亿美元	联咏、瑞鼎及集创北方等
HBM 芯片	HBM 报价持续上升，涨势延续至 2025 年	SK Hynix、三星及 Micron 等
AI 芯片	Intel 的 Gaudi 芯片订单已达 20 亿美元	英伟达、AMD 及华为等

资料来源：芯八哥整理

2、风险

12月，关注日系厂商扩充对手机供应链影响，PMIC 领域价格战风险持续。

图表 24：12月细分市场风险预警

产品	风险预警	相关企业
MLCC	村田拟扩大对中国低端智能手机厂商销售零部件	村田、TDK、国巨及三环等

产品	风险预警	相关企业
CIS	索尼拟扩产 CIS 增加对华手机厂商出货	索尼、豪威及三星等
PMIC	TI 为首 PMIC 价格倒挂持续	TI、ADI 及矽力杰等

资料来源：芯八哥整理

六、小结

2023Q4，随着终端需求温和复苏，各品类芯片交期和价格大幅修复，下游客户恢复正常提货节奏。国际部分主流机构上修 2024 年全球半导体市场规模预期，芯八哥对此认为，半导体行业或已走出周期底部。

展望 2024 年，总体市场趋势向好，但是结构性分化依然存在。具体来看，消费电子温和回升，电动汽车和 AI 相关需求维持高速增长，工业和通信持续库存去化，谨慎关注新能源需求变化。

免责声明

本文由华强电子网集团旗下媒体芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

华强电子网集团旗下媒体芯八哥

2024年1月

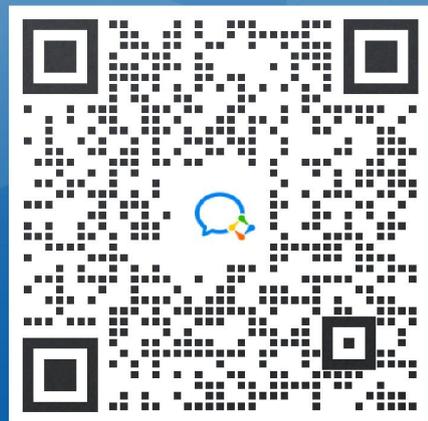


<<< 扫码关注“芯八哥”

及时获取更多半导体市场采购及销售情报、
厂商动态和行业趋势报告

加入芯八哥半导体行业交流群 >>>

群内每日分享行业前沿资讯，还有精品报告、
行业白皮书免费领取





更高效 更透明 重构产业生态

仓储服务 元器件采购 信息服务 API/FTP
PCB制板 BOM工具 SAAS

www.hqengroup.com

深圳总部

电话：86-755-83396000

传真：86-755-26421633

地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦
B座4、7、12楼